

文一三佳科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 6 月 17 日（星期一）上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动形式召开了 2023 年度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司已于 2024 年 6 月 7 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《文一科技关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告》（临 2024-024）。2024 年 6 月 17 日上午，公司董事长杨林先生，董事总经理丁宁先生，副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生，独立董事储昭碧先生，董事会秘书夏军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2023 年度经营成果、财务状况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会，公司就本次会上投资者提出的问题及预征集的问题给予了回答。现将本次业绩说明会提出的主要问题及答复情况整理如下：

1、投资者提问：公司未来的分红计划和派息政策如何安排？

回复：我公司章程已按照最新分红政策做了修订，公司将按照公司章程及有关规定，结合公司净利润、未分配利润、法定盈余公积等财务数据，在条件允许的情况下，进行分红或派息安排，响应政策要求，积极回报投资者。

2、投资者提问：文一科技研究院设立的初衷是什么？筹建进展如何？主要研究哪些项目？进展情况怎样？

回复：2023年11月份，我公司在合肥设立了文一科技研究院。研究院设立的目的是，跟上半导体行业、客户技术进步的步伐；承担中长期研发项目和关键共性技术研发；开展对外合作，加快半导体产业升级、产品迭代；培养半导体产业发展需要的技术人才；减小因地域差别对高端研发人才引进的影响。目前，其办公场所、研发人员宿舍已装修完毕，运营机制、组织架构已搭建完毕，招聘人员也将陆续到位。经公司内部遴选，目前确定了塑封体切割和先进封装等两个项目立项工作。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司

二〇二四年六月十七日